

## 电迁移对Ni/Sn3.0Ag0.5Cu/Cu焊点界面反应的影响

黄明亮, 陈雷达, 周少明

大连理工大学材料科学与工程学院, 大连 116024

EFFECT OF ELECTROMIGRATION ON INTERFACIAL REACTION IN Ni/Sn3.0Ag0.5Cu/Cu FLIP CHIP SOLDER JOINTS

HUANG Mingliang, CHEN Leida, ZHOU Shaoming

School of Materials Science & Engineering, Dalian University of Technology, Dalian 116024

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献\(29\)](#)

[相关文章 \(15\)](#)

[点击分布统计](#)

[下载分布统计](#)

版权所有 © 2008 《金属学报》编辑部

地址: 沈阳市文化路72号, 中国科学院金属研究所(110016)

电话: +86-024-23971286, 传真: +86-024-23843760 E-mail: jsxb@imr.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn

美女图片

美女 美女美女 美女美女